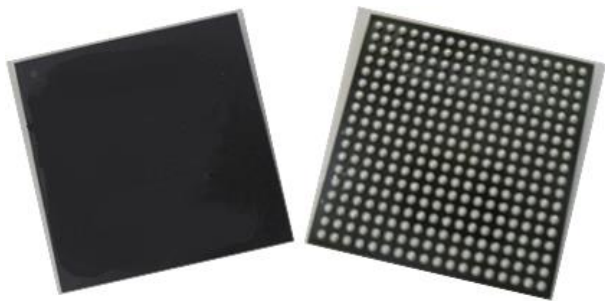


対松堂

リワーク事業のご紹介



リワーク対応工場



海外のリワーク作業風景



ベトナム ハイズン工場



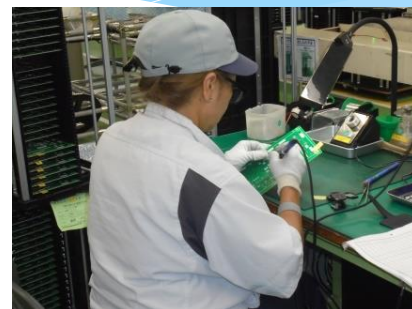
中国 深セン工場



中国 蘇州工場

リワーク対象品目例

- BGA部品取り外し
- BGA部品取り付け
- リボール作業
- QFP部品取り外し
- QFP部品取り付け
- 検査（目視・X線のみ）
- ベーキング



価格例①

価格	日本	中国(深圳) (US\$)	中国(蘇州) (US\$)	ベトナム (US\$)
BGA交換	8,000円	40.00	40.00	32.00
BGAリボール	7,000円	別途	別途	対応無し
検査(目視・X線)	1,000円	別途	別途	別途
ベーキング(1set)	700円	別途	別途	別途
QFP(多PIN)交換	5,000円	20.00	20.00	11.00
IC(少PIN)交換	2,500円	13.00	13.00	6.00

価格例②

価格	日本	中国(深圳) (US\$)	中国(蘇州) (US\$)	ベトナム (US\$)
放熱パッドのあるIC 部品交換	5,000円	26.00	26.00	12.00
BGA用メタルマスク (必要時)	別途	別途	別途	別途
その他 改造等	別途	別途	別途	別途

※汎用部品は在庫がございますのでご相談ください。

※送料は対応地域毎に別途お見積とします。



納期・条件

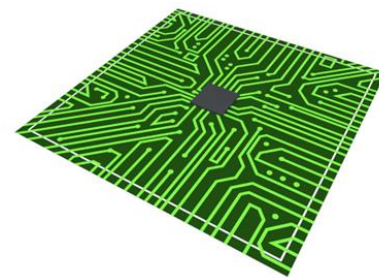


- **納期は基板が弊社に到着後、約1週間です。**
- **基板破損の場合は、責任を負いかねます。**
- **送料・納期は別途お見積を致します。**
- **基板・部品は無償支給にてお願い致します。**
- **価格表は一例になります。価格表に無い作業・数量が多い場合・定期的に発生する場合は別途ご相談ください。**
- **はんだ、フラックスは当社標準品を使用します。**

その他・注意事項

下記条件によっては別途ご相談させて頂く場合がございます。

- 周りに部品が密集している等、該当部品以外にも部品交換が必要になる基板
- 基板サイズ



詳細は下記までお問い合わせください。